

## **有研半导体硅材料股份公司**

### **2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”或“有研硅”）董事会将2023年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

#### **一、募集资金基本情况**

##### **（一）实际募集资金金额和资金到账情况**

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2047号），同意公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）18,714.3158万股，每股发行价格为9.91元，募集资金总额为人民币185,458.87万元，扣除不含税发行费用，实际募集资金净额为人民币166,396.72万元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年11月7日出具《验资报告》（毕马威华振验字第2201588号）。

##### **（二）募集资金使用和结余情况**

截至2023年6月30日，本公司募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金专项账户期初余额	784,407,766.66
减：报告期内投入募集资金总额	404,578,944.07
减：项目相关设备采购信用证保证金存入扣除实际对外支付净额	5,863,307.89
减：对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品投入减去赎回本金净额	-125,016,086.80
减：支付的其他发行费用	6,612,264.02
加：报告期内对募集资金进行现金管理取得的收益及利息收入扣除手续费净额	17,694,439.36
募集资金专项账户期末余额	510,063,776.84

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

公司已与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司北京航天城支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、中国民生银行股份有限公司北京东单支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司、本公司之子公司山东有研半导体材料有限公司已与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行、中信银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储

四方监管协议》，对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年6月30日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行名称	银行账号	金额	备注
中国民生银行股份有限公司北京东单支行	637336316	439,649,748.52	活期存款
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	110907342310257	1,824,087.05	活期存款
中信银行北京中信大厦支行	8110701013402425110	67,276,815.89	活期存款
中国工商银行股份有限公司北京航天城支行	0200302619100012252	930,617.66	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行	91170078801400002732	382,507.72	活期存款

## 三、本年度募集资金的使用情况

### （一）募投项目的资金使用情况

公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金，公司本报告期募投项目的资金使用情况，详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

### （二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2023年3月28日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过《关于募集资金置换已投入自有资金的议案》，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金置换情况进行了审验，并

于2023年3月28日出具《关于有研半导体硅材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第2300402号）。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有研半导体硅材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-011）。

公司于2023年4月至5月陆续对各项目先期投入进行置换，明细如下：

单位：人民币元

项目名称	置换金额
集成电路用8英寸硅片扩产项目	57,511,327.42
集成电路刻蚀设备用硅材料项目	35,824,527.50
发行费用	8,804,094.35
合计	102,139,949.27

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2022年11月17日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司计划使用不超过人民币166,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有研半导体硅材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。

本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

单位：人民币元

签约银行	产品名称	余额	是否如期归还
中国民生银行北京东单支行	结构性存款	500,000,000.00	是

中国工商银行北京航天城支行	七天通知存款	384,824,300.00	是
中国民生银行北京东单支行	结构性存款	200,000,000.00	是
中信银行北京中信大厦支行	结构性存款	250,000,000.00	是
浦发银行北京知春路支行	结构性存款	100,000,000.00	是
中国民生银行北京东单支行	结构性存款	450,000,000.00	是
浦发银行北京知春路支行	利多多通知存款	109,808,213.20	未到期,随时支取
浦发银行北京知春路支行	结构性存款	200,000,000.00	未到期
中国民生银行北京东单支行	结构性存款	200,000,000.00	未到期
中信银行北京中信大厦支行	结构性存款	250,000,000.00	未到期

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2023年3月28日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟用于永久补充流动资金的金额为19,500万元，占超募资金总额的比例为29.37%。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有研半导体硅材料股份公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-012）。

公司于2023年5月12日将19,500万元超募资金永久补充流动资金。

报告期内，公司不存在超募资金归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在使用节余募集资金的情况。

**四、变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及《募集资金管理制度》使用募集资金，并真实、准确、完整、及时履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2023年8月10日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额(注 1)				1,663,967,265.37		本年度投入募集资金总额				404,578,944.07		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				408,566,606.81		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1) (注 2)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充研发与运营资金	无	257,828,100.00	257,828,100.00	257,828,100.00	96,450,326.35	100,437,989.09	-157,390,110.91	38.96	不适用	不适用	不适用	否
集成电路用 8 英寸硅片扩产项目	无	384,824,300.00	384,824,300.00	384,824,300.00	70,556,280.61	70,556,280.61	-314,268,019.39	18.33	未到期	不适用	不适用	否
集成电路刻蚀设备用硅材料项目	无	357,347,600.00	357,347,600.00	357,347,600.00	42,572,337.11	42,572,337.11	-314,775,262.89	11.91	未到期	不适用	不适用	否
一、承诺投资项目小计	——	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	209,578,944.07	213,566,606.81	-786,433,393.19	21.36	——	——	——	——
超募资金永久补流	无	不适用	195,000,000.00	195,000,000.00	195,000,000.00	195,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
其他超募资金	无	不适用	468,967,265.37	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
二、超募资金小计	——	不适用	663,967,265.37	195,000,000.00	195,000,000.00	195,000,000.00	-	100.00	——	——	——	——
合计	——	1,000,000,000.00	1,663,967,265.37	1,195,000,000.00	404,578,944.07	408,566,606.81	-786,433,393.19	34.19	——	——	——	——
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见三、(二)募投项目先期投入及置换情况。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						报告期内,公司未发生此情况						
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况						详见三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						详见三、(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。						
募集资金结余的金额及形成原因						不适用						
募集资金其他使用情况						不适用						

注 1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币 1,663,967,265.37 元。

注 2：由于公司未承诺截至期末投入金额，此处填写为募集资金承诺投资总额。